

平成 23 年 6 月 20 日

お客様各位

東京エレクトロデバイス株式会社
設計開発センター 品質保証部
部長 本下 英治**TE7720PF ウェーハ径 及び 組立材料 変更について**

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、貴社にてご採用頂いておりますTE7720PFにつきまして、ウェーハ径及び組立材料の変更がございます。下記の通りご報告させていただきますので、宜しくお願い申し上げます。

内容につきましてご確認の上、返信用用紙にご捺印を頂き、お手数ですがご返信頂きたく存じます。

敬具

< 記 >

1. 対象型格：TE7720PF
2. 変更内容：
 - 1) 生産ライン移管によるウェーハ径変更；
【変更前】6インチウェーハ（φ150mm）
【変更後】8インチウェーハ（φ200mm）
 - 2) ボンディングワイヤ・モールド樹脂材料の変更；
【変更前】ボンディングワイヤ；Au材、モールド樹脂；エポキシ Type-B
【変更後】ボンディングワイヤ；Cu材、モールド樹脂；エポキシ Type-C

*材料変更により製品に含まれる化学物質情報(成分表)は変更となりますが、
型格、電気的特性、パッケージ寸法、実装保証条件などの製品仕様の変更はございません。
3. 変更理由：東日本大震災に伴う納入への影響を回避するためのウェーハ径変更および材料変更による安定供給、材料統一による生産性向上。
4. 移管時期：2011年9月頃
弊社の在庫状況により、実施時期が多少前後することがございます。
詳細は、別途ご連絡させていただきます。
5. 識別方法：ロットナンバーにて識別可能です。詳細は、別途ご連絡させていただきます。
6. 添付資料：組立材料変更による「成分表」をご参照頂けますようお願いいたします。

返却用

inrevium

TDGS27027

平成 23 年 6 月 20 日

お客様各位

東京エレクトロデバイス株式会社
設計開発センター 品質保証部
部長 本下 英治



TE7720PF ウェーハ径 及び 組立材料 変更について

内容につきましてご確認の上、返信用用紙にご捺印を頂き、お手数ですがご返信頂きたく存じます。

< 記 >

1. 対象型格：TE7720PF
2. 変更内容：
 - 1) 生産ライン移管によるウェーハ径変更；
【変更前】 6 インチウェーハ (φ 150 mm)
【変更後】 8 インチウェーハ (φ 200 mm)
 - 2) ボンディングワイヤ・モールド樹脂材料の変更；
【変更前】 ボンディングワイヤ；Au 材、モールド樹脂；エポキシ Type-B
【変更後】 ボンディングワイヤ；Cu 材、モールド樹脂；エポキシ Type-C

*材料変更により製品に含まれる化学物質情報(成分表)は変更となりますが、
型格、電気的特性、パッケージ寸法、実装保証条件などの製品仕様の変更はございません。
3. 変更理由：東日本大震災に伴う納入への影響を回避するためのウェーハ径変更および材料変更による安定供給、材料統一による生産性向上。
4. 移管時期：2011年9月頃
弊社の在庫状況により、実施時期が多少前後することがございます。
詳細は、別途ご連絡させていただきます。
5. 識別方法：ロットナンバーにて識別可能です。詳細は、別途ご連絡させていただきます。
6. 添付資料：組立材料変更による「成分表」をご参照頂けますようお願いいたします。

貴社受領印欄	
日付：	_____
貴社名：	_____
部署名：	_____
ご署名：	_____ 印

東京エレクトロデバイス株式会社
設計開発センター 品質保証部

TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED